

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024-051

## 宝鼎科技股份有限公司

### 关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

#### 一、募集资金及投资项目概况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由独立财务顾问中信证券股份有限公司于2022年9月23日向招金有色金属矿业有限公司发行普通股（A股）股票26,690,391股，每股面值1元，每股发行价人民币11.24元。公司本次募集资金299,999,994.84元，扣除发行费用13,911,972.06元，募集资金净额286,088,022.78元。截止2022年9月23日，上述募集资金全部到位，经中天运会计师事务所“中天运[2022]验字第90052号”验资报告验证确认。

根据《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金投资项目拟用于投入标的公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）“7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”、补充上市公司流动资金及支付中介机构费用。公司募集资金投资项目及投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	募集资金使用规模
1	7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目	66,567.99	25,000.00
2	补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	5,000.00	5,000.00
	合计	71,567.99	30,000.00

## 二、本次拟调整募集资金投资项目总投资规模的情况

### 1、原募投项目计划和实际投资情况

项目名称	7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目
实施主体	山东金宝电子有限公司
实施地点	山东省烟台市招远市开发区金晖路229号
项目总投资规模	66,567.99万元
募集资金承诺投资金额	25,000.00万元
具体建设内容	厂房厂区建设、设备购置及安装、铺底流动资金
实施方式	新建
截至2024年6月30日,已使用募集资金金额	10,016.95万元(其中含利息收入17.00万元)
项目达到预定可使用状态的时间	2024年12月

### 2、本次调减项目总投资规模的情况(单位:万元)

根据项目可行性研究报告,公司拟对“7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔”募投项目投资规模进行调减,由年产7,000吨减少到2,000吨,项目总投资由66,567.99万元减少到25,700.00万元,其中募集资金投入由25,000.00万元减少到18,000.00万元,其余7,700.00万元为金宝电子自筹资金投入。募投项目投资规模调整前后对比情况如下(单位:万元):

调整前					调整后				
项目名称	总投资	募集资金拟投资总额	累计已投入募集资金总额	剩余募投资金总额	项目名称	总投资	募集资金拟投资总额	累计已投入募集资金总额	剩余募投资金总额
7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目	66,567.99	25,000	9,999.95	15,000.05	2,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目	25,700.00	18,000	9,999.95	8,000.05

注:1)“累计已投入募集资金总额”为截至2024年6月30日的投入总额(不含利息收入);

2)“剩余募投资金总额”不含利息收入和理财收益,未扣除银行手续费。

### 三、调减募投项目总投资规模的原因

《山东金宝电子有限公司7000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目可行性研究报告》于2020年8月获得环评批复,之后市场环境发生了较大变化。据中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会(CCFA)统计,2020年以后,国内铜箔产能迅速增长。2021年至2023年,国内新增电子铜箔产能分别是11.3万吨、41.2万吨、54.0万吨,三年时间产能增长了1.8倍,但是产能利用率却连

年下滑。2023 年国内电子铜箔总产能为 167.0 万吨，总产量为 94.0 万吨，产能利用率仅为 56.3%，开工率严重不足。另据 CCFA 调查统计，2024 年仍然有 68.0 万吨的在建产能计划要投产。铜箔产能增长速度远超出下游需求增长速度，形成现阶段铜箔产能相对过剩局面。同时，市场竞争激烈，铜箔加工费低于成本线，全行业进入微利或亏损状态。CCFA 建议，对新上项目要考虑停建、缓建、调整（即降低）投建规模。

针对现阶段国内电子铜箔产能过剩和下游电子行业需求疲软，为降低投资风险，提高资金利用率，公司董事会根据市场变化情况，拟对募投项目投资规模进行上述调整。

#### **四、调减的募集资金使用计划**

本次募投项目规模调整后，公司拟将结余募集资金 7,000 万元及利息永久补充流动资金。公司调整募投项目投资规模是根据国内外市场环境变化及公司发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低投资风险，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。调减后剩余募集资金永久补充公司流动资金，有利于进一步充盈公司现金流，改善财务状况和提升资产质量。

#### **五、对公司的影响**

公司本次变更部分募集资金投资项目投资规模，符合公司实际情况和募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，能够尽快实现项目建设，保障公司持续发展，符合公司全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目投资规模没有与募投项目的实施计划相抵触，并未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金使用计划及主要内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情形。公司将严格遵守相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

#### **六、相关意见**

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目投资规模并拟将结余募集资金及利息永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意该事项。

## 七、相关风险提示

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、《山东金宝电子有限公司 2000 吨/年高速高频板 5G 用（HVLP）铜箔项目可行性研究报告》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金之专项核查意见》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 24 日